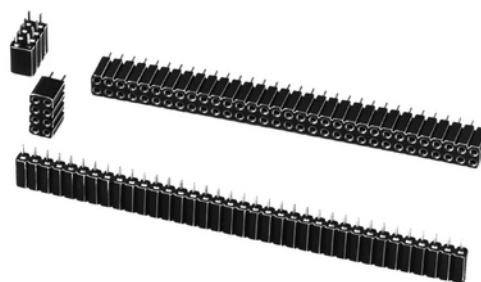


# Präzisions-Buchsenleisten, RM 2,54mm, gerade, 1-/2-reihig, Bauhöhe 7,0mm

## Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Single/Double Row, 7.0mm Profile

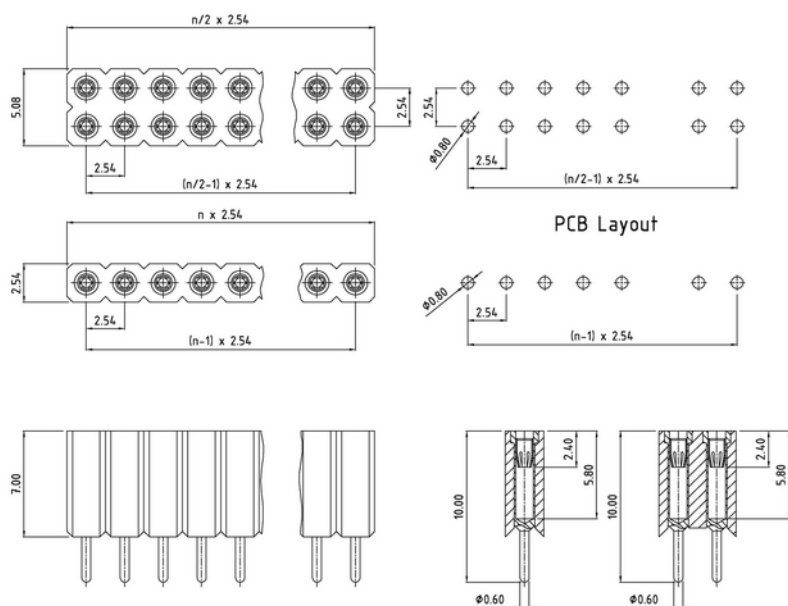
### Technische Daten / Technical Data

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Isolierkörper         | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0                           |
| Insulator             | Thermoplastic, rated UL94 V-0                                         |
| Kontaktmaterial       | Hülse: Messing gedreht<br>Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer    |
| Contact Material      | Sleeve: screw machined brass<br>Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper |
| Kontaktoberfläche     | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)                      |
| Contact Surface       | Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)                  |
| Lötbarkeit            | IEC 60512-12A                                                         |
| Solderability         | IEC 60512-12A                                                         |
| Durchgangswiderstand  | < 10mΩ                                                                |
| Contact Resistance    | < 10mΩ                                                                |
| Isolationswiderstand  | > 1000MΩ                                                              |
| Insulation Resistance | > 1000MΩ                                                              |
| Spannungsfestigkeit   | 1kV <sub>RMS</sub>                                                    |
| Test Voltage          | 1kV <sub>RMS</sub>                                                    |
| Nennspannung          | 100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub> max.                         |
| Voltage Rating        | 100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub> max.                         |
| Nennstrom             | 3A                                                                    |
| Current Rating        | 3A                                                                    |
| Temperaturbereich     | -55°C ... +125°C                                                      |
| Temperature Range     | -55°C ... +125°C                                                      |
| Verarbeitung          | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren                                      |
| Processing            | Wave or reflow soldering                                              |



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø 0,65 - 0,85mm  
oder Vierkantstifte 0,635mm und für  
Rundstifte Ø 0,4 - 0,56mm oder Vierkantstifte  
0,25 x 0,4mm auf Anfrage.  
Accept round pins Ø 0.65 - 0.85mm or square  
pins 0.635mm and round pins Ø 0.4 - 0.56mm  
or square pins 0.25 x 0.4mm on request.



### Series

153

### Contacts\*

002

002-050 Einreihig  
Single row  
004-100 Zweireihig  
Double row

### Rows\*

1

1 Einreihig  
Single row  
2 Zweireihig  
Double row

### Sleeve Plating

50

50 Hülse verzinkt  
Tin plated sleeve

### Clip Plating\*

00

00 Feder vergoldet  
Gold plated clip  
10 Feder 0,25µm Gold  
0.25µm gold plated clip  
30 Feder 0,75µm Gold  
0.75µm gold plated clip  
50 Feder verzinkt  
Tin plated clip

Auch dreireihig lieferbar!  
Triple row also available!

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL [sales@wppro.com](mailto:sales@wppro.com)  
WEBSITE [www.wppro.com](http://www.wppro.com)

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren

### Wave Soldering Information

## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

Recommended wave soldering profile:



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft                    | Kennwert     |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum $T_{Smin}$        | 150°C        |
| Temperatur Maximum $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$          | 60-180s      |
| Temperatur Lötbereich $T_L$          | 217°C        |
| Verweildauer oberhalb $T_L$          | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur $T_P$               | 260°C ±5     |
| Dauer Höchsttemperatur               | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$  | Max. 8 min   |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature                      | Key Values   |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature $T_{Smin}$       | 150°C        |
| Maximum Temperatur $T_{Smax}$        | 200°C        |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$       | 60-180s      |
| Soldering Range Temperature $T_L$    | 217°C        |
| Duration above $T_L$                 | 60-180s      |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$        | max. 3°C / s |
| Peak Temperature $T_P$               | 260°C ±5     |
| Duration Peak Temperature            | 20-40s       |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s      |
| Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$     | Max. 8min    |

